

◆ セミナー開催のお知らせ ◆

熱設計での CAE 活用手法 ～解析はどのように行うべきか？～

講師：国峯 尚樹 氏
(株) サーマル・デザイン・ラボ 代表取締役

2018年1月23日 CIAJ 装置実装委員会

日時：2018年2月23日(金) 16:00-17:30

場所：CIAJ B/C 会議室

東京都港区浜松町 2-2-12

TEL 03-5403-9359

講師：国峯 尚樹 氏

(株) サーマル・デザイン・ラボ 代表取締役

演題：「熱設計での CAE 活用手法 ～解析はどのように行うべきか？～」

＜一般公開セミナー＞

受講希望者は 2 月 15 日までに「<https://cp11.smp.ne.jp/ciaj/seminar>」よりお申し込み下さい。なお、定員になり次第、締め切りとなります。ご提供いただきました個人情報、CIAJ からの各種ご案内等に利用させていただきます場合がございますので予めご了承下さい。

■講師紹介（敬称略）

国峯 尚樹（くにみね・なおき）

1977年 沖電気工業（株）入社

2007年 （株）サーマル・デザイン・ラボ設立

主な著書

- ・電子機器の熱流体解析入門 第2版（日刊工業）
- ・熱設計と数値シミュレーション（オーム社）
- ・トコトンやさしい熱設計の本（日刊工業）
- ・電子機器の熱流体解析入門（日刊工業）
- ・トラブルをさけるための電子機器の熱対策設計 第2版（日刊工業）
- ・エレクトロニクスのための熱設計完全入門（日刊工業）

■講演概要

熱流体シミュレーションが普及し、モノづくり前のある程度の熱問題を検出できるようになりました。しかし、プリント基板に目を移すと数百～千を超える部品が両面に実装され、微細化された配線パターンで接続されています。100%の部品をモデル化して検証することはほぼ困難で、どこかで部品形状を省略せざるを得ません。解析者はどのような基準でモデル化する部品を選別しているのでしょうか？危険な部品を見逃してしまったら、致命的な結果を招きます。高密度実装が進む現在、人によって変わることがない、客観的で合理的な判断基準が必要です。

本講演では、こうした定量的判断基準について考察し、その方法について提言します。

以上